

～真空貼合装置～

	小型	中型
対応基板寸法	4～8インチ (アクティブエリア)	8～20インチ (アクティブエリア)
塗布方式	スロットダイによる面塗布	
樹脂硬化方式	塗布直後（貼合前）のライン照射 または 全面一括照射（紫外線LED光源）	
貼合方式	真空チャンバー内でのプレス貼合	
貼合ポジション	1～4ポジション (装備数量は選択可能です)	1～2ポジション (装備数量は選択可能です)
アライメント方式	メカニカル または CCD+精密ステージ (精度はご要望に応じて決定)	
対応樹脂タイプ	紫外線硬化樹脂 (OCR)	
ユーティリティ	電気・エアー・真空・冷却水	
オプション	シール塗布・硬化、保護フィルム剥離、プラズマ処理、自動供給排出、生産管理システム etc.	